

# 国信证券股份有限公司关于深圳丹邦科技股份有限公司 2011年度募集资金存放与使用情况的专项报告

国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”或“保荐机构”）作为深圳丹邦科技股份有限公司（以下简称“丹邦科技”或“公司”）首次公开发行股票保荐机构。我公司根据《深圳证券交易所中小企业板保荐工作指引》、《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等规定，对公司2011年度募集资金存放与使用情况进行了专项核查，具体情况如下：

## 一、保荐机构进行的核查工作

国信证券保荐代表人通过与公司董事、监事、高级管理人员、内部审计、注册会计师等人员交谈，查询了募集资金专户，查阅了年度募集资金存放与使用情况的专项报告以及各项业务和管理规章制度，从公司募集资金的管理、募集资金的用途、募集资金的信息披露情况等方面对其募集资金制度的完整性、合理性及有效性进行了核查。

## 二、募集资金基本情况

公司于2011年9月7日首次公开发行人民币普通股4,000万股股票，并于2011年9月20日在深圳证券交易所中小企业板挂牌交易。本次募集资金总额为52,000.00万元，发行费用合计2,410.73万元，其中国信证券股份有限公司承销佣金、保荐费用合计1,760.00万元，丹邦科技其他发行费用650.73万元，扣除上述2,410.73万元发行费用后的募集资金净额为49,589.27万元。上述募集资金净额已经天健会计师事务所有限公司天健验[2011]3-55号《验资报告》验证。

截至2011年12月31日，公司累计已使用募集资金22,562.99万元（包括公司已置换的先期投入募集资金项目的自筹资金20,072.07万元），累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为52.62万元，公司募集资金余额为人民币27,078.90万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）。

## 三、募集资金管理情况

### （一）募集资金的管理

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《深圳丹邦科技股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。

根据相关规定，公司对募集资金实行专户存储，公司与保荐机构于2011年10月分别与中国建设银行股份有限公司深圳科苑支行、中国工商银行股份有限公司深圳喜年行签订了《募集资金三方监管协议》，于2011年12月与中国工商银行股份有限公司侨城西街支行签订了《募集资金三方监管协议》，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。截至2011年12月31日，公司严格按照该《募集资金专用账户管理协议》的规定，存放和使用募集资金。

## （二）募集资金专户存储情况

截至2011年12月31日，公司有3个募集资金专户，募集资金存放情况如下：

单位：人民币元

账户名称	开户银行	银行账号	募集资金余额
深圳丹邦科技股份有限公司	中国工商银行股份有限公司深圳喜年支行	4000093229100007218	380,253.91
深圳丹邦科技股份有限公司	中国建设银行股份有限公司深圳科苑支行	44201515200059002618	70,954,555.20
广东丹邦科技有限公司	中国工商银行股份有限公司深圳侨城西街支行	4000093229100009270	199,454,172.86
合 计			270,788,981.97

## 四、2011年度募集资金的实际使用情况

### （一）募集资金使用情况对照表

截至2011年12月31日，公司实际使用募集资金22,562.99万元，具体如下表：

单位：人民币万元

募集资金总额		49,589.27		本年度投入募集资金总额		22,562.99				
报告期内变更用途的募集资金总额		-		已累计投入募集资金总额		22,562.99				
累计变更用途的募集资金总额		-								
累计变更用途的募集资金总额比例		-								
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%) (3) = (2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化

承诺投资项目											
基于柔性封装基板技术的芯片封装产业化项目	否	42,500.00	42,500.00	22,562.99	22,562.99	53.09%	2012年12月30日	0.00	不适用	否	
承诺投资项目小计	-	42,500.00	42,500.00	22,562.99	22,562.99	53.09%	-	0.00	-	-	
超募资金投向											
柔性封装基板材料及工艺技术与产业化项目	否	7,089.27	7,089.27	0.00	0.00	0.00%	2012年11月30日	0.00	不适用	否	
归还银行贷款(如有)	-							-	-	-	
补充流动资金(如有)	-							-	-	-	
超募资金投向小计	-	7,089.27	7,089.27	0.00	0.00	-	-	0.00	-	-	
合计	-	49,589.27	49,589.27	22,562.99	22,562.99	-	-	0.00	-	-	
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	不适用										
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用										
超募资金的金额、用途及使用进展情况	<p>公司第一届董事会第二十五次会议审议通过了《关于使用超募资金及自筹资金投资建设“柔性封装基板材料及工艺技术与产业化项目”的议案》(该议案已于2012年1月5日经公司2012年第一次临时股东大会批准),公司决定使用超募资金7,089.27万元投资建设“柔性封装基板材料及工艺技术与产业化项目”。截至2011年12月31日,尚未对该项目投入资金。</p>										
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用										
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用										
募集资金投资项目先期投入及置换情况	<p>公司第一届董事会第二十一次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》,公司决定使用募投项目资金置换截止到2011年9月30日公司前期已预先投入募投项目的自筹资金,置换金额为人民币20,072.07万元。</p>										
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用										
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用										
尚未使用的募集资金用途及去向	存放于募集资金专户中										

募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无
----------------------	---

## （二）本年度超额募集资金的使用情况

2011年12月19日，公司第一届董事会第二十五次会议审议通过了《关于使用超募资金和自筹资金投资建设“柔性封装基板材料及工艺技术与产业化项目”的议案》，公司使用超募资金7,089.27万元和自筹资金7,910.73万元投资建设“柔性封装基板材料及工艺技术与产业化项目”。

## 五、其他事项

截止至2011年12月31日，公司不存在募集资金投向变更、擅自改变实施地点、违规使用的情况，公司募集资金相关信息不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况。

## 六、保荐机构核查的结论性意见

经核查，保荐机构认为：2011年度，公司能够按照《深圳证券交易所股票上市交易规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和公司《募集资金管理制度》等法规制度的要求进行募集资金的管理和使用，不存在违反上述相关法规的情形。

（以下无正文）

【本页无正文，为《国信证券股份有限公司关于深圳丹邦科技股份有限公司  
2011 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》之签字盖章页】

保荐代表人：

\_\_\_\_\_

曾军灵

\_\_\_\_\_

崔 威

国信证券股份有限公司

2012 年 4 月 8 日